



電子基板の高速・高精細 温度計測

高速・高分解能の赤外線カメラを用いて、基板の温度変化を可視化します。

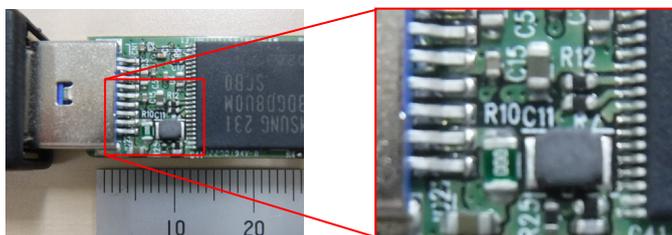
特徴

- 電子基板上に発生する高速の温度変化を画像やグラフで「見える化」します。
- 高速・高精細に撮影した温度画像により、局所的な発熱箇所を特定できます。
 - ・ 最大で3000fps以上の撮影速度（撮影時間間隔300 μs以下）で撮影・記録できます。
 - ・ パワーデバイス的高速昇温や、高速スイッチングによる温度変化などを測定できます。
 - ・ 当社保有の拡大レンズにより、1画素あたり最小約10 μmの高分解能で撮影できます。

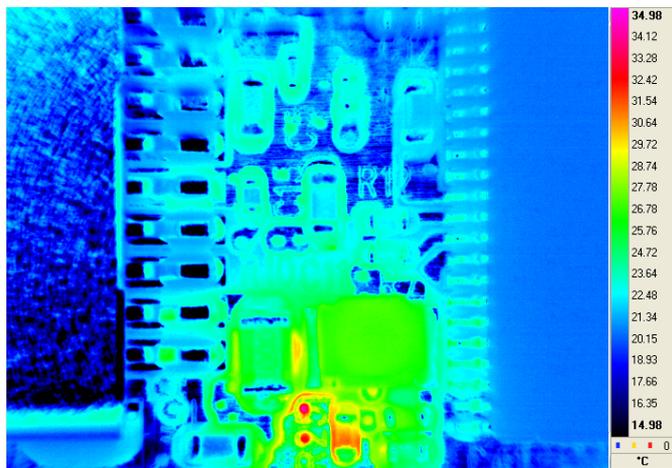
カメラの主な仕様

型式	撮影速度	画素数 X × Y	温度分解能	測定温度範囲
FLIR X6580sc	355 fps	640 × 512 pixel	< 20 mK	-20 ~ +3000 °C
Cedip SC5500M	383 fps	320 × 256 pixel	< 20 mK	+5 ~ +1500 °C
	1250 fps	160 × 128 pixel		
	3590 fps	80 × 64 pixel		

高精細温度計測の事例

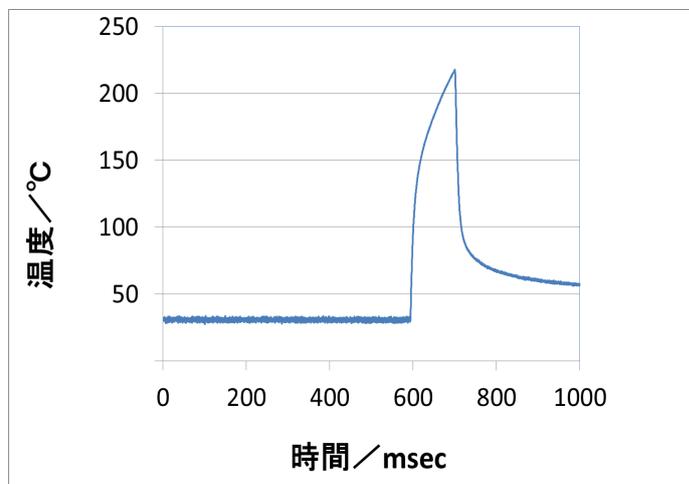


デジタルカメラ撮影画像



高精細温度画像の例

高速温度計測の事例



温度変化測定結果例

高速温度計測の事例

- 負荷やサンプルの違いによる発熱状態の検証
- 欠陥発生箇所の特定
- 発熱対策の効果検証 など



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2019 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。